

divisione **SERITRONICS**



STENCIL E TELAI SERIGRAFICI PER SMT E FILM SPESSO.



TECNOLOGIE INNOVATIVE CHE FANNO LA DIFFERENZA...

Seritronics fornisce un servizio custom di ottimizzazione file su ogni apertura in base alle esigenze specifiche del cliente.

Studi di fattibilità per saldatura componenti through hole con tecnologia SMT.

Consulenza su montaggio componenti QFP, BGA e micro BGA con realizzazione effetto auto-allineamento stencil.

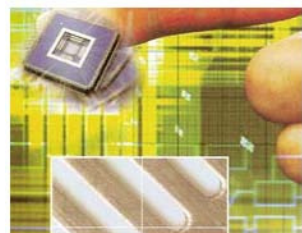
Lamine per punti colla con soluzioni innovative.

Lamine brevettate con rete fotoincisa integrata.

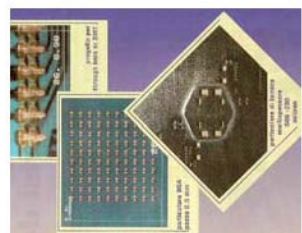
Tecnologia per componenti 04-02 e 02-01.

Stazioni di rework per BGA e CSP.

Servizio C/T di arricchimento pasta su componenti CSP.



I brevetti Seritronics di "cianfrinatura" e "corazzatura" applicati agli stencil SMD garantiscono la resa di processo anche in presenza di schede estremamente complesse e componenti fortemente critici.



Rework e reballing di micro componenti con possibilità di arricchimento pasta su componenti CSP:

Seritronics fornisce ai propri clienti sia il servizio che le attrezzature e relativo know-how.

**AZIENDA LEADER NEI SERVIZI PER TECNOLOGIA SMT E FILM SPESSO.
CONSULENZA E ASSISTENZA SU TUTTO IL PROCESSO SERIGRAFICO.
FORNITURA STENCIL / TELAI SERIGRAFICI ED ACCESSORI.**

GRUPPO

SOCIETA' ITALIANA per il CHEMICAL MACHINING SpA

Via Marcora, 36-38 20097 San Donato Milanese (MI)
tel. +39.02.55601901 fax +39.02.55607171
www.cm-italia.it e-mail : info@cm-italia.it

SMT / Film Spesso.

La divisione **SERITRONICS** del gruppo Chemical Machining SpA è specializzata nella fornitura di Telai Serigrafici e Stencil per tecnologia SMT e Film Spesso.

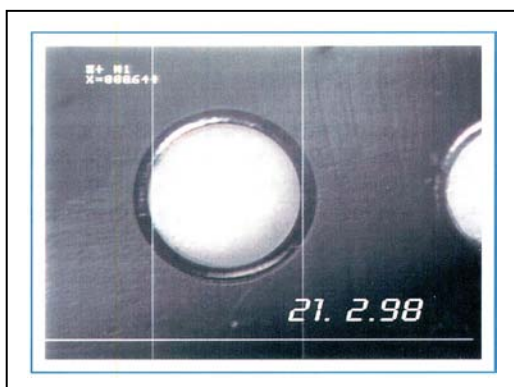
SERITRONICS Srl avvia la produzione di telai serigrafici di alta precisione per circuiti ibridi a film spesso ed SMT nel 1987.



Con l'introduzione sul mercato di componenti elettronici con package sempre più ridotto, le innovazioni tecnologiche Seritronics su lamine e telai si rendono obbligatorie per ottenere un giunto di saldatura corretto e affidabile anche su componenti 0201,0402, flip chip e csp ottenendo sempre una stampa senza rework. Seritronics offre una vasta gamma di soluzioni tecniche su telai serigrafici per stampa SMT.

Cianfrinatura e Corazzatura contribuiscono ad ottenere la massima resa di processo ottenibile durante la fase di stampa. I nostri telai garantiscono una stabilità nel tempo ottimale senza modificare la resa di processo durante la lavorazione.

Il nostro reparto ricerca e sviluppo è sempre aggiornato sulle ottimizzazioni su ogni nuovo componente.

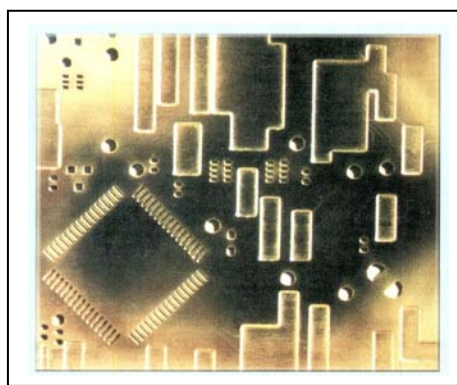


cianfrinatura e corazzatura (patent pending)

<-----

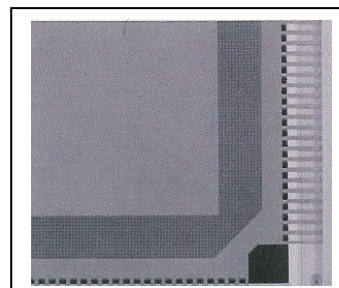
Lamina con profilo adattato in coincidenza di sovrappessori PFT

----->



NEW !!! Lamina rete (patent pending)

Grazie al nuovo sistema di lamina rete, brevettato da Seritronics, il telaio autobalace colma la distanza tecnologica verso i telai tradizionali. La rete incisa sulla lamina conferisce una elasticità senza precedenti, lasciando inalterata la tensione a 50 newton. La resa di processo ne risulta avvantaggiata, e assicura risultati ottimi paragonabili ai telai serigrafici tradizionali più evoluti.



NEW !!! BGA MATE-04 : Sistema innovativo per Rework e Reballing :

Vantaggi : 1. Garanzia di un deposito di pasta saldante che livella e assicura una ottima planarità sulle tolleranze delle balls. 2. Ampia superficie a disposizione per la stesura della pasta saldante (80 x 80 mm circa). 3. Semplice esecuzione con personale non specializzato (corso max 2 ore). 4. Controllo del deposito stampato con lente 5X. 5. Manipolazione del componente, dopo la stesura della pasta saldante, senza particolari accorgimenti critici. 6. Drastica riduzione degli shock termici sul componente. 7. Inserimento del componente nel nozzle in modo facile. 8. Garanzia che i giunti di saldatura saranno senza corti circuiti. 9. Garanzia che i giunti di saldatura saranno esenti da vuoti.



I ns. tecnici sono a Vs. disposizione per affrontare insieme a Voi problematiche particolari quali lo studio custom di lamine SMD per la saldatura di componenti tradizionali con tecnologia SMD e fornire consulenza su auto-allineamento componenti BGA. Inoltre proponiamo: sistemi dedicati per l'analisi della deteriorabilità della pasta saldante durante il ciclo di lavorazione (solder-balling test), attrezzature dedicate alla pulizia dei telai serigrafici, accessori per serigrafia. **Per gli operatori che utilizzano componenti CSP, Seritronics propone un servizio di arricchimento pasta, indispensabile per un semplice e corretto montaggio di questi componenti di ultima generazione.**